**攻讀博士學位計畫書及自傳**

1. **研究計畫名稱**

建置智慧型半導體晶粒外觀缺陷檢測模型

1. **計畫摘要**

半導體封裝產業中，晶粒的品質與產品外觀息息相關，而傳統透過人工目檢的方式檢查晶粒須要花費大量時間及人力才能運作，且人員標準可能不一，長時間的目檢作業也容易造成視覺疲乏，導致缺陷漏檢。

為了減少人員目檢疏失及導入自動化生產，現今晶粒外觀異常檢測多倚靠自動光學檢測儀器(Automated Optical Inspection, AOI)完成，不過在半導體出貨良率要求非常嚴格的條件下，為了不讓任何一顆缺陷晶粒漏檢，工程人員通常會將自動光學檢測儀器判定缺陷的敏感度調高，導致過檢率提高(部分站點過檢率可達80%以上)，影響整體生產良率。

計畫預透過設計一深度神經網路模型於自動光學檢測儀器判定之異常圖片覆判，預期能正確判定異常圖片、正常圖片及規格內圖片，以節省覆判人力。

1. **研究計畫內容**
2. **研究計畫之背景及目的**

台灣半導體封測在全世界具有舉足輕重的腳色，隨著手機、3C用品日益普及的情況下，也有愈來愈多電子化產品問世，應用範圍也更加廣泛，全球對於半導體的需求也日益擴大。

台灣半導體代工產業追求低成本、高良率、短生產周期，因此，大部分半導體廠紛紛開始導入工廠自動化的解決方案，以減少搬運、生產、檢測的人力，減少人員操作錯誤，及加速檢測時間，來達成無人工廠的目的。

在半導體封裝檢測的項目中，又以晶粒外觀缺陷檢測為大宗，而傳統透過人工目檢的方式檢查晶粒須要花費大量時間及人力才能運作，且人員標準可能不一，長時間的目檢作業也容易造成視覺疲乏，導致缺陷漏檢。

為了減少人員目檢疏失及導入自動化生產，現今晶粒外觀異常檢測多倚靠自動光學檢測儀器(Automated Optical Inspection, AOI)完成，不過在半導體出貨良率要求非常嚴格的條件下，為了不讓任何一顆缺陷晶粒漏檢，工程人員通常會將自動光學檢測儀器判定缺陷的敏感度調高，導致過檢率提高(部分站點過檢率可達80%以上)，影響整體生產良率。

故封測廠常會再安排人員對於自動光學檢測儀器所判定之缺陷晶粒進行覆判，以減少報廢良品晶粒，另外，部分外觀缺陷晶粒為客戶允收範圍，此類晶粒屬於規格良品，屬於易過檢類別。

多數研究已針對自動光學檢測儀器判定結果開發自動化影像覆判系統，系統會判斷自動光學檢測儀器輸出的晶粒圖片是否為外觀缺陷，不過由於規格良品上的缺陷容易導致系統的判定失誤，以及有些缺陷種類辨識成效不彰，故本計畫預設計一深度神經網路模型於自動光學檢測儀器判定之異常圖片覆判，除了判斷預辨識的晶粒圖片以外，另外加入了自動光學檢測儀器提供的限度樣品圖片(golden sample image)作為比對參考，預期能正確判定異常圖片、正常圖片及規格內圖片，以節省覆判人力。

1. **研究方法、進行步驟**
2. **預期完成之工作項目及成果**
3. **參考文獻**